

Presseinformation

Viscom präsentiert neues hochauflösendes Kameramodul für die Inline-Drahtbondprüfung

Hannover, März 2017 – SMT Hybrid Packaging, Halle 4A, Stand Nr. 122

Die Viscom AG bietet für die zuverlässige Inspektion von Drahtbonds das neue Kameramodul XM Bond HR an. Zu seinen Eigenschaften zählen u. a. eine Bildfeldgröße von 21 mm x 21 mm und eine besonders gute Detailauflösung. Ideal geeignet ist es für genaueste Kontrollen von Dünndrähten in der Fertigungslinie.

Mit dem neuen Kameramodul XM Bond HR erweitert Viscom die Konfigurationsmöglichkeiten für die Drahtbondinspektion weiter in Richtung höchste Inline-Prüfqualität. Besonders empfehlenswert ist sein Einsatz vor allem dort, wo in sicherheitsrelevanter Elektronik Dünndrähte mit einem Durchmesser von z. B. nur 20 µm verbaut werden. Dazu gehören u. a. diverse Arten von Signalverarbeitung in den Bereichen Automotive und Aerospace.

Eine extrem gute Bildqualität und Detailauflösung werden dank der hochwertigen optischen Komponenten und der erstklassigen Auflösung und Empfindlichkeit der Sensorchips erreicht. Neben der Bildfeldgröße von 21 mm x 21 mm bietet das XM Bond HR eine Auflösung von 4,5 µm pro Pixel. Ein telezentrisches Objektiv garantiert, dass ein Prüffenster unabhängig vom Objektabstand denselben Abbildungsmaßstab besitzt, also z. B. die Endpunkte eines geprüften Dünndrahtes im Prüffenster immer exakt an denselben Positionen liegen. Die telezentrische Optik verhindert zudem, dass Bereiche der Baugruppe neben hohen Bauteilen verdeckt werden.

Eine integrierte z-Achse mit 20 mm Hub sorgt für einen optimal auf die Objekthöhe einstellbaren Schärfebereich. Aber auch hinsichtlich des optischen Ausgleichs von Höhenunterschieden hat Viscom die Aufnahmeal Qualität weiter verbessert. Gleichzeitig wurden die Möglichkeiten zielgerichteter Beleuchtung für diverse spezifische Anwendungen ausgeweitet.

Besonders geeignet ist das XM Bond HR für die Inline-Systeme S6053BO-V und S6056BO von Viscom, die sich u. a. durch vielseitig konfigurierbare Transport- und Handlingmöglichkeiten auszeichnen. Die Sensorik ist über die Softwareplattform SI genauso einfach anzusteuern, wie es die Bediener anderer Viscom-Inspektionslösungen schon kennen. Fertigungslien können jetzt folglich mit noch besserer Technik für die Drahtbondprüfung ausgestattet werden, die bei Durchsatz, Taktzeit und Prüftiefe höchsten Ansprüchen genügt.

Über Viscom

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert Viscom seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörsse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen:
www.viscom.de